

Pressa Idraulica Riscaldata Automatica 75T Piastre 500X500Mm Temperatura E Pressione Programmabili Con Raffreddamento Ad Acqua

Numero articolo: XP60



introduzione

Ideale per applicazioni di laboratorio e pilota, questa pressa riscaldata automatica da 75 tonnellate presenta ampie piastre da 500x500mm, controllo della temperatura PID doppio indipendente con rampe programmabili, profilatura della pressione in anello chiuso e canali di raffreddamento ad acqua integrati per un rapido raffreddamento. Richiedi un preventivo oggi.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Stampaggio di Compositi in Fibra di Carbonio	Consolidazione ad alta temperatura e alta pressione di preimpregnati termoplastici o termoindurenti rinforzati con fibra di carbonio o vetro in pannelli strutturali leggeri, piastre o componenti per aerospaziale, automobilistico e articoli sportivi.	Pressione e temperatura uniformi su tutta l'area di 500x500 mm eliminano le vuoto e garantiscono una bagnatura uniforme delle fibre e proprietà meccaniche costanti.
Laminazione PCB Multistrato & CCL	Stampaggio a caldo di precisione di circuiti stampati multistrato, laminati rivestiti di rame e circuiti flessibili utilizzando profili di temperatura e pressione a più fasi per ottenere un affidabile bonding interstrato.	Il controllo di rampa programmabile minimizza lo shock termico e previene la delaminazione, l'insellamento e l'estrusione della resina, risultando in schede ad alta affidabilità.
Pressaggio di Elettrolita & Elettrodi per Batterie allo Stato Solido	Stampaggio a caldo di strati di elettrolita solidi in ceramica o polimero e elettrodi composti per ottenere alta densità e contatto interfacciale intimo per batterie allo stato solido.	La profilatura della pressione in anello chiuso e il riscaldamento uniforme garantiscono nastri di elettrolita densi e privi di difetti con conduttività ionica migliorata e integrità meccanica.
Fabbricazione MEA Cella a Combustibile	Produzione di assemblaggi elettrodo-membrana (MEA) saldando membrane rivestite di catalizzatore con strati di diffusione del gas sotto calore e pressione controllati per celle a combustibile PEM.	Il controllo delicato della forza e l'uniformità precisa della temperatura prevengono danni alla membrana ottenendo un'adesione e prestazioni ottimali dello strato catalizzatore.
Bonding di Wafer Semiconduttori	Bonding per termocompressione di wafer semiconduttori o substrati di dispositivi per MEMS, sensori, integrazione 3D e incapsulamento avanzato, spesso richiedendo un allineamento preciso dell'espansione termica.	Le rampe programmabili e la stabilità della temperatura di $\pm 1^\circ\text{C}$ sulla piastra minimizzano lo stress di disallineamento termico e garantiscono una qualità di legame uniforme.
Produzione di Film & Fogli in Polimero	Stampaggio per compressione e appiattimento di film, fogli o laminati termoplastici per la preparazione di campioni o la produzione su piccola scala di film ottici, materiali di imballaggio o campioni di ricerca.	La capacità di alta pressione e il rapido raffreddamento ad acqua consentono tempi di ciclo rapidi e producono film piatti e rilassati con spessore controllato.
Preparazione Campioni per Test Materiali Compositi	Preparazione di provini standardizzati da laminati compositi o giunti incollati secondo metodi ASTM/ISO, garantendo qualità dei provini ripetibile per test meccanici.	I cicli automatizzati e programmabili forniscono una preparazione dei campioni costante, riducendo la variabilità e migliorando l'affidabilità dei dati di test.
R&S Compressione Compresse Farmaceutiche	Compressione a caldo di piccoli lotti di polveri farmaceutiche in compresse utilizzando stampi riscaldati per valutare formulazioni che richiedono attivazione termica o per produrre compresse a rapida disintegrazione.	I profili di pressione e temperatura programmabili con rapido raffreddamento consentono un controllo preciso sulla durezza, porosità e proprietà di dissoluzione delle compresse.

Parametro	Specificazione
Modello	XP60

Parametro	Specificazione
Pressione Massima	75 Tonnellate (750 kN) - Sistema idraulico automatico
Controllo Pressione	Programmabile con rampa (automatico in anello chiuso)
Temperatura di Lavoro Piastra	0 - 300 °C
Controllo Riscaldamento	Riscaldamento indipendente doppia piastra, controllo PID programmabile con rampa; supporta profili di temperatura a più stadi
Dimensione Piastra	500 x 500 mm
Apertura Piastra	100 mm
Potenza Riscaldamento	Approx. 10 kW (riscaldamento a doppia zona ad alta potenza)
Metodo di Raffreddamento	Raffreddamento ad acqua circolante (richiede refrigeratore esterno)
Alimentazione	AC 380V/50Hz o AC 208V/240V/480V Trifase 60Hz (personalizzato per mercato USA se richiesto)
Dimensioni Attrezzatura	Approx. 680 x 680 x 1280 mm (telaio verticale industriale ad alta rigidità)
Peso Netto	Approx. 1130 kg (attrezzatura pesante, richiesto scarico con muletto professionale)